

智造未来“胶”点，支撑半导体及新能源产业跨越的底层逻辑

2026年3月25至27日，2026慕尼黑上海电子生产设备展（productronica China）将在上海新国际博览中心（E1-E5, W1-W4馆）盛大举办。作为电子制造行业重要的展示与交流平台，本届展会以近100,000平方米展示面积、超1,000家参展企业的规模，聚焦汽车、工业、通讯电子、医疗电子等多领域需求，旨在为行业呈现一场覆盖电子生产全产业链的“创新盛宴”，重点聚焦智慧工厂、新能源汽车技术及数字化未来。

观众预登记，火热进行中



扫码注册参观，现场免排队入场

随着半导体先进制程向更深维度探索，以及新能源汽车电子等应用对极端环境适应能力的诉求提升，产业链的关注点正加速向底层工艺回溯。在这一背景下，流体控制不再仅仅是简单的点胶或涂覆工序，它已深度融入产品的可靠性设计体系，成为解决热管理、信号干扰及结构补强的关键环节。

与此同时，产业的竞争维度正在发生重构：硬件设备正向着具备高精度计量、全制程真空环境处理及全自动化在线监控的方向迭代，与之配合的材料科学，则在导热、防护以及极速固化等性能指标上不断突破边界。这种“双向奔赴”，不仅提升了生产线的柔性及吞吐量，更在关键环节上加速了国产化供应链的体系化渗透。

攻克微米级阵地，高精度计量与全制程真空灌封技术进阶

随着元器件间距向微米级缩进，传统的点胶工艺面临着气泡残留、胶量波动以及高粘度材料难以均匀填充等技术瓶颈，特别是在严苛的工况下，微小的气泡可能导致局部放电或散热失效，这对设备的真空预处理与精密计量提出了更高要求。行业亟需通过全制程的真空控制与非接触式喷射技术，解决材料在高频、高压环境下的稳定输出难题。

苏州韩迅机器人作为国家高新技术企业，深耕胶水灌封领域，凭借自主研发的双组份真空备料系统及活塞泵多嘴注胶头等核心技术，在汽车电子及半导体模块灌封等关键领域成功实现了国产替代。针对高填料胶水易磨损、易结晶导致维护成本高的挑战，其全自动多头流水线真空灌胶机高集成度的一体式柱塞阀可定制1-10个胶嘴，适配常温至100℃的复杂灌封应用。搭配全自动真空备料单元，从材料预处理到灌胶整个过程可以实现全程真空状态等特点。



图源：苏州韩迅机器人

深圳市欣音达科技专注于无限循环容积式流体计量，旨在解决流体填充与封装中的精准配比与无脉动点胶难题。其明星产品XYD-ZKV3三段式真空注胶系统采用了独特的设计，将抽真空、注胶与泄压操作分布在三个独立的真空箱内，通过工控机及Windows平台专业软件实现精确管理。该系统利用螺杆泵恒压供料与二次计量技术，使得出胶速度可在0.01g/s至30g/s的广泛范围内调节且不受胶量限制，显著提升了汽车电子、工业电子及新能源领域的整体生产效率。



广州慧炬智能主要应用于分立器件等封装领域尤其 MEMS 制程中 ASIC 芯片包封、膏精密涂布，应用于包含引线框架型芯片封装（Leadframe Package），基板型芯片封装（Substrate Package），管壳型芯片封装（Shell & Case Package）等封装形式，包括芯片包封（Chip Coating）、锡膏涂布（

Solder Paste Painting)、灌胶 (Potting)、器件加固 (Component Reinforced - gluing)、芯片底部填充 (Underfill) 等工艺应用。



图源：慧炬智能

P-MASTER通过推出非接触式压电喷射系统PV3500A系列，有效解决了传统针头点胶难接触和刮伤产品的工艺痛点。该喷射系统利用压电快速精确的运动原理，能够喷射出极小的胶点和清晰的线条，并对起止操作进行精确控制，适

用于高中低粘度的胶水，如Primer，热熔胶，红胶，银浆，底填胶等多种介质。目前，该技术已广泛应用于手机外框、摄像头模组、LSR防水，AR/VR眼镜，AI服务器及半导体行业，是实现微量控制点胶的可靠伙伴。



图源：P-MASTER

耐驰（兰州）泵业依托德国耐驰150余年的流体处理积淀，为电子元件制造提供了高精度且易控制的Dispenser分配器。针对精密点胶中物料易受损及脉动干扰的挑战，耐驰分配器采用容积式排出原理，确保高磨蚀性和粘性液体的计量进料具有高度可重复性。其NEMO®单螺杆泵更具备在负压状态下反向运行抽除气泡的功能，且过流部件材料多样，确保无金属磨蚀微粒进入介质，满足了微芯片制造对体积小、精度高的极端要求。



图源：耐驰（兰州）泵业

志圣科技针对半导体后道工序中的晶圆处理需求，其UW-281晶圆UV解胶机专门适用8"-12"晶圆的UV解胶制程。为了应对不同制程对波长的要求，其UV点灯系统可共享365nm及405nm波长灯管，并支持30%-100%的功率调节。设备在UV室内加装了传感器进行能量反馈，并配备移动冷风机与N2装置，确保在解胶过程中温度可控且具备超温保护，通过无刷马达控制输送速度，实现了晶圆处理的高稳定性。



图源：志圣科技

广东浦森塑胶从点胶产业链的末端耗材出发，致力于解决胶水在输送过程中的固化、变形及污染问题。其明星产品美式系列针筒采用进口食品级抗寒抗冲击原料，无任何润滑剂或脱模剂添加，确保胶水质量长时间稳定。该针筒能够

在-40 至100 环境下工作，抗UV波长0-400nm（100%防UV），并可承受6公斤压力，广泛应用于LCD、LED、半导体及声学等对纯净度要求极高的行业。



图源：广东浦森塑胶

攻克微米级阵地，高精度计量与全制程真空灌封技术进阶

除了设备创新外，5G、自动驾驶及军工电子的迅猛发展，对设备在高温、高湿、高腐蚀环境下的长期可靠性提出了挑战，这高度依赖于胶粘剂在粘接、导热与密封维度的多重突破。目前，高性能硅基材料与纳米防护涂层正成为解决设备“短寿命”与“热失控”问题的关键手段，国产材料在这一领域的突破正逐步缩小与国际先进水平的差距。

硅宝科技旗下的导热胶等明星产品，针对新能源汽车、锂电池及光伏太阳能等高功率产出领域提供了针对性的密封与散热方案。通过全国9大生产基地的布局，硅宝科技正以规模化优势支持电子电器与电力环保行业的国产材料配套需求。



图源：硅宝科技

杭州之江在工业电子领域，可为半导体、IGBT、LED、具身智能机器人、MEMS传感器、车载显示、汽车电子、储能、动力电池、消费电子、车灯、家电、电梯、航空航天、船舶等多个领域提供有机硅、聚氨酯、环氧等一系列粘接、密封、灌封，以及导热、阻燃、导电、绝缘等功能性应用产品，为客户提供一站式应用解决方案。



图源：杭州之江

拜高材是一家专注于电子胶粘剂的高新技术企业。公司以有机硅、聚氨酯、环氧树脂及丙烯酸树脂四大核心技术体系为支撑，致力于为高端制造领域提供可靠的粘接、灌封与导热解决方案。产品广泛应用于新能源汽车三电系统（

电池、电机、电控)、汽车电子、储能系统、光伏逆变器及半导体封装等前沿领域。公司在动力电池热管理、高压连接器密封、电控系统防护等应用场景积累了丰富的解决方案经验，以材料创新助力客户提升产品可靠性与性能表现。



图源：拜高高材

熙邦新材料作为光通信行业专业粘接剂供应商，通过与国外技术团队合作，为光通信用胶粘剂应用提供全系列解决方案。其掌握的热固与UV+热固型环氧胶粘剂体系，涵盖了单双组份等多种应用工艺，解决了光通信与微电子行业的粘接密封难题。目前，SUP-BOND粘接剂已在5G通信、车载激光及芯片封装等领域应用，并获得了IATF16949等体系认证。



图源：熙邦新材料

郑州中原思蓝德产品体系涵盖了环氧、硅酮、聚氨酯及结构胶膜等全系列，其明星产品如MF281H导热硅脂、MF1326环氧粘接胶及MF1309室温快固型环氧树脂胶，广泛应用于航空航天、军工及电力防腐等领域。公司依托国家级CNAS实验室，主编了百余项行业标准，为电子密封材料的标准化与国产可靠性提供了强力支撑。



图源：郑州中原思蓝德

德国CHT集团针对电子设备元件小型化带来的热量聚集挑战，提供了全面散热解决方案。其核心SILSO®COOL硅胶粘合剂通过在硅胶聚合物中引入特殊填料，在保持硅胶物理特性的基础上极大增强了导热性能。这些材料制成的密封剂、封装化合物及间隙填充剂，即便在恶劣环境及长期高温影响下依然能保持出色的柔韧性。通过有效散发处理器、电源单元及LED组件的热量，CHT的UL认证系列产品显著提升了传感器与散热器件的导热效率，从而延长了终端产品的使用寿命。



图源：德国CHT集团

铠博新材料深耕工业粘接密封材料研发，聚焦电子与新能源热管理推出全新产品线，涵盖硅橡胶、UV胶、环氧修补剂等多品类胶粘剂。针对电子设备及新能源高要求应用场景，铠博导热界面材料含导热垫片、单/双组分导热凝胶，低热阻、贴合性佳，适配自动化点胶，为动力电池、大功率电子器件提供稳定传热路径；三防UV胶专为PCB精密防护设计，快速固化、附着力强，可抵抗潮湿、盐雾腐蚀，为精密电路、连接器PIN针等提供长效绝缘防护，助力提升产品耐用性。



图源：铠博新材料

深圳市超防新材料专注于纳米新材料的研发，旨在解决高端基础材料长期依赖进口的局面，全自主研发出具有自主知识产权的系列新型材料。其超疏水防护材料具备防水、防短路、防腐蚀及良好的散热特性，解决了传统三防材料涂层厚的局限。该材料可在室温下小于60秒快干，且具有电性能优异、可修复等优点，是当前高新技术产业和材料行业的特色产品。



图源：深圳市超防新材料

同期论坛 | 【2026机器人及高端电子用胶粘材料创新研讨会】议程公布



09:30-10:00 上午会议签到



10:00-10:25

3M在人形机器人装配中的粘接解决方案
1、3M人形机器人行业整体解决方案概览
2、3M胶带及胶粘剂产品在人形机器人组装中的应用
贺祥 3M中国有限公司 資深应用开发工程师



10:25-11:20

Solstice应用于人形机器人的热界面材料
1、Solstice导热材料在人形机器人中的潜在应用
康诗柏 Solstice公司 全球产品经理



11:20-11:45

派克洛德在人形机器人的粘接和导热解决方案
1、派克洛德在人形机器人整体解决方案概述
2、派克洛德产品在人形机器人的应用与案例
罗苏脱 洛德化学(上海)有限公司 商务拓展经理



11:45-12:10

胶粘剂如何助力机器人产业链发展
1、机器人行业概况
2、具身机器人产业链发展趋势及对胶粘剂技术要求
3、德邦科技胶粘剂在具身机器人产业链用胶解决方案初探
高德顺 烟台德邦科技股份有限公司 产品经理



12:10-12:35

胶联机器人未来：艾盛新材料创新解决方案
1、机器人产业发展现状与用胶需求升级
2、艾盛新材料在机器人领域的应用
3、艾盛新材料简介和新产品发布
常峰 艾盛(浙江)新材料有限公司 副总经理

上午会议总结

13:00-13:30 下午会议签到



13:30-13:55

低空经济与机器人产业发展新观察与胶粘剂应用机会挑战
1、低空经济产业当下发展进程与未来关键节点
2、低空经济产业带给胶粘剂的增量机遇与挑战
3、机器人产业当下发展进程与新趋势变化
4、机器人产业带给胶粘剂的增量机遇与挑战
卜林 上海研至企业管理咨询有限公司 咨询业务总监



13:55-14:20

高可靠性电子应用聚合物的选择
1、聚合物增强解决方案
2、聚合物保护解决方案
3、热管理解决方案
蒋奕 奥德美法 高级业务拓展工程师



14:20-15:15

TBD



15:15-15:40

针对未来消费电子产品导热凝胶应用及技术发展趋势
1、系统级芯片对散热材料提出新要求
2、导热凝胶在消费电子领域的应用
3、导热凝胶的技术发展趋势
郑旭 南氏公司 高级研究科学家



15:40-16:05

高性能胶粘剂在智能电子设备中的应用
1、迪马电子系列胶粘剂综合解决方案
2、消费电子行业创新应用
3、汽车电子行业创新应用
4、新兴电子行业创新应用
李鑫 迪马新材料科技(苏州)有限公司 总监



16:05-16:30

双组份丙烯酸酯结构胶在电子市场的开发与应用
1、双组份丙烯酸酯结构胶产品介绍
2、影响产品性能的关键因素
3、核心应用领域
伍奕 康达新材料(集团)股份有限公司 研发工程师

全天会议总结



即刻扫码注册
抢占听会席位

※具体议程以当天实际情况为准



扫码进入小程序了解更多论坛详情

电子制造的精密化演进已进入深水区，点胶封装环节正在从单一的辅助工艺转向系统级的可靠性保障。未来的产业竞争力将高度取决于流体控制设备对复杂介质的精确管理，以及封装材料在多维度物理特性上的平衡。为了近距离感受这些前沿技术，我们诚挚邀请您注册观展2026年3月25-27日在上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子生产设备展，届时，上述优秀的点胶与材料厂商将悉数到场，为您展示极具参考价值的行业应用案例与解决方案，共同探讨电子制造的未来可能。

完成观众预登记，免排队入场



扫码注册参观，现场免排队入场



扫描下方二维码或前往：<https://dwz.cn/QajmGxOT>
，免费注册参观2026慕尼黑上海电子生产设备展，免排队入场快人一步！



productronica CHINA
慕尼黑上海电子生产设备展
2026年3月25-27日
上海新国际博览中心



扫码注册参观

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_244427.html